黑芝麻智能 20260831

黑芝麻智能 2026H1 研报：营收增 81%，舱驾融合与具身智能迎量产拐点

摘要

- 2026H1 营收 4.59 亿元（同比+81.3%），芯片出货超 600 万颗，具身智能收入 4,700 万元成为第二增长曲线。
- A1,000 稳步放量；C1,200 舱驾一体芯片 2026H2 量产爬坡；A2000 高阶芯片已获 5+车型定点，2027 年迎大规模放量。
- 收购珠海亿智补齐低功耗 SoC 版图，其 2026H1 收入 1.6 亿元并扭亏为盈，助力集团构建全场景端侧 AI 矩阵。
- 具身智能业务毛利高于车载，Leora 模组已完成头部人形机器人验证，预计 2026Q4 至 2027Q1 开启规模化量产。
- 坚持生态合作路线，A2000 已跑通元戎启行算法；下一代支持大模型的高性能推理芯片预计 2027 年底推出。
- 商用车领域 A1,000 域控已覆盖 50%国内前十新能源轻卡主机厂，预计 2027 年新能源车厂覆盖率达 80%以上。
- 维持全年亏损收窄指引，通过高端产品（A2000/C1,200）放量及亿智并表协同，优化收入结构并对冲价格战压力。

Q&A

请总结公司 2026 年上半年的整体经营表现、战略升级以及对未来发展的展望？

2026 年上半年，公司经营可总结为三点：主业稳健兑现，新赛道拐点已至，全栈战略全面落地。公司已从智能驾驶芯片供应商升级为覆盖智能汽车、具身智能及泛端侧 AI 的全场景端侧算力平台，以应对行业从云端训练向端侧推理、效率和数据安全切换的结构性趋势。 在核心车载业务方面，已形成 A1,000、C1,200、A2000 三款芯片的完整产品梯队。A1,000 作为成熟主力芯片，依托国标 AEB 和 NOA 方案，在存量车型中稳步放量，夯实了业绩基本盘。舱驾融合的 C1,200 芯片已完成方案验证，将于 2026 年下半年开始批量爬坡，预计 2027 年迎来多个车

型定点和大规模放量。高阶算力的 A2000 芯片已取得高阶方案定点，并正与更多头部乘用车企进行 POC 测试，将为 2027 年的高阶智驾业务增长打开空间。同时，下一代产品的预研已经启动。 在具身智能新赛道，该业务已成为公司确定的第二增长曲线。2026 年上半年，机器人业务在头部主机厂实现放量。公司采取小客户破局、大客户深耕的双轨策略，聚焦协作机器人、轮式底盘等场景，并与美的、中远海控等行业头部企业联合开发。 在资本运作与战略整合方面，公司于上半年完成了对珠海亿智的收购。亿智已实现亿级芯片出货，具备成熟的商业化能力和供应链体系。未来将全面打通双方在技术、客户和供应链等方面的资源，构建覆盖高阶算力到高性价比通用算力的完整产品矩阵，补全全场景端侧 AI 布局。 展望未来，公司的研发思路将依托自研 NPU 原生架构优势，深耕端侧大模型和物理 AI 的落地场景，重点提升有效算力、推理效率和每瓦性能，通过持续迭代芯片架构、带宽、互联和数据处理能力，深度适配汽车和机器人等全品类端侧 AI 应用。

公司 2026 年上半年的具体财务数据和业务出货情况如何？对全年的盈利预期是否有调整？

2026 年上半年，集团实现营业收入 4.59 亿元，较 2025 年同期增长 81.3%。该收入不包含 6 月 29 日完成并表的亿智电子的业务。上半年集团芯片总出货量超过 600 万颗。其中，具身智能及解决方案业务实现收入 4,700 万元，业务规模持续扩大，已成功商业化落地，成为集团的第二增长曲线。 尽管报告期内研发费用因前瞻性的高阶智驾芯片流片及 IP 采购费用提前支出而同比有所上升，但基于下半年高端车载芯片的量产落地、具身智能业务规模的持续放大以及亿智并表带来的收入增长等多重利好，集团维持全年亏损收窄的经营指引，盈利改善的大方向没有改变。

公司如何看待当前智能汽车行业的竞争格局与结构性机会，以及相应的产品布局和市场策略？

尽管智能汽车行业面临挑战，但结构性机会正在凸显，产品结构升级正对冲低端产品的盈利压力，高端高算力产品占比的持续提升是公司盈利韧性的核心来源。行业趋势方面，舱驾一体赛道正处于高速增长期，预计 2026 年舱驾一体架构渗透率将突破 30%，为公司的 C1,200 产品带来巨大的市场机会。高算力赛道呈现结构性分化，超过 100 TOPS 算力区间的国产芯片市占率在持续提升，但超过 300 TOPS 算力的高阶市场仍由国外巨头主导，这为国产替代留下了广阔的市场潜力。公司的产品迭代策略是，通过 C1,200 舱驾一体芯片和华山 A2000 高阶智驾芯片，逐步对存量的 A1,000 产品形成替代升级。具体而言，武当 C1,200 系列作为国内首个量产落地的舱驾一体芯片平台，已搭载东风的天元智舱平台，预计 2026 年下半年迎来批量化装车交付。华山 A2000 高阶算力芯片已获得多个车型 L2+到 L3 级别的量产定点，将于下半年正式进入量产阶段。同时，成熟的 A1,000 系列产品继续在东风、一汽、比亚迪等客户中稳定放量，贡献基础收入。随着 C1,200 和 A2000 等高价值产品在后续量产交付中占比不断提升，将持续优化车载板块的

收入结构，以抵御行业价格竞争带来的压力。

公司具身智能业务的进展、盈利能力及客户合作情况如何？

公司的具身智能及解决方案业务已从项目验证阶段迈向规模化增长阶段，2026年上半年实现营业收入4,700万元。从财务角度看，机器人赛道属于高毛利的新兴市场，其盈利能力显著高于传统的车载智驾业务。随着规模效应的释放，该业务未来将成为提升集团整体盈利水平的关键板块。 在产品和应用方面，公司的Colors和Aura平台已在机械臂、协作机器人、四足巡检机器人上实现规模化出货。全新的Leora模组已完成头部人形机器人厂商的算法验证，即将送样，该模组可替代海外高成本的算力方案。 在客户合作方面，公司已与智谱AI、联想、美的、中远海控等一批产业链龙头企业建立了深度合作，与其他头部客户的合作也在稳步推进中。预计下半年将有更多订单落地，业务将处于快速规模扩张期，高增长属性明确。

收购亿智电子对公司有何战略意义？双方将如何进行业务协同？

对亿智电子的收购，补齐了公司在高性价比和低功耗端侧SoC方面的能力，完成了公司在端侧AI推理芯片领域的完整版图搭建。 从行业趋势看，全球视觉终端AI推理芯片的出货量预计到2030年将达到2.4亿颗，其中算力大于1 TOPS的中高端芯片出货增速更快，预计到2026年将达到42%左右，市场增长空间广阔。亿智电子具备成熟的ISP、NPU、音视频编解码等全套自研技术，在行车记录仪、安防视觉终端等领域已实现千万级出货量，并在端侧AI核心的感知本地推理领域有深厚积淀。同时，亿智已与影石、小米等大客户绑定，切入了AI眼镜、智能车载、运动相机、智能云台等新兴物理AI终端市场。 完成并表后，双方将在产品规划、客户资源、算法工具链及供应链等方面进行深度协同。具体而言，将亿智在高性价比、低功耗视觉终端方面的能力，与公司在高阶智驾、机器人算力平台方面的优势形成互补。这将进一步扩展集团的收入来源，分散单一赛道的周期性风险，形成车载智驾业务压舱、具身智能业务拉动增量、泛端侧AI业务扩展边界的业务组合。

公司为实现全年经营目标，在财务和运营层面的后续重点工作有哪些？

为稳步实现全年亏损收窄的目标，公司后续在财务和运营层面有四项重点工作：第一，推动A2000、C1,200等高端产品的量产落地，提升高附加值产品的收入占比。预计2026年下半年将看到这两款芯片的逐步批量出货，2027年将成为大规模批量化出货的元年。 第二，加快具身智能业务的规模化，推动更多项目从验证阶段走向批量交付，以充分释放该赛道的高毛利优势。 第三，深度完成与亿智电子的业务协同，释放协同效应，做大泛端侧AI的业务盘子，抓住高端视觉端侧芯片的行业红利。 第四，持续做好研发投入的管控、供应链与营运资金管理，在兼顾技术迭代的同时，稳健提升经营效率。

关于高阶智驾芯片 A2000，截至目前取得了哪些客户进展？下半年的客户拓展策略是怎样的？

华山 A2000 系列是公司高阶辅助驾驶业务的核心产品线之一。2026 年上半年，公司围绕 A2000 持续推进与主机厂的方案开发、工程适配、送样和定点量产合作，目前已获得五个以上车型的定点。下半年将重点推进两方面工作：一是推动已进入项目阶段的方案尽快完成量产导入；二是扩大 A2000 在头部乘用车、商用车、无人物流以及 L3、L4 场景的车型覆盖，以达成全年获得 10 个车型定点的目标。下半年的客户拓展策略将采取产品分级、分赛道的模式，针对 A2000、C200、A1,000 及定制 SoC 业务匹配不同客户和场景：

1. A2000 高阶算力芯片：重点攻坚主机厂的平台级高阶智驾定点，争取获得下一代电子电气架构平台的选型，以带动多车型的复用。在机器人和商用车领域，将推动 Alpha 项目的量产开发。
2. C200 平台：基于已有的舱驾一体项目经验，向更多自主品牌和合资品牌客户复制推广方案，以扩大舱驾一体定点的基数。
3. A1,000 平台：重点深挖存量客户的复用需求，包括商用车保险 ADAS 模式，并拓展在工业及边缘计算领域的 AI 应用场景。
4. 定制化 SoC：针对重点 OEM 客户开展芯片定制合作。
5. 海外市场：一方面跟随国内整车厂及 Tier1 的出海配套智驾方案；另一方面直接开发海外本土合作伙伴，优先落地标杆性的 POC 项目并转化为量产定点。通过这种分层产品与海内外市场的协同，持续扩大在车厂的定点规模和芯片出货基础。

收购亿智电子后，公司在非车业务板块将产生哪些具体变化？

亿智电子的并表显著拓展了公司的业务边界。亿智电子补齐了公司在高性价比、低功耗端侧 AI SoC 方面的能力，其 NPU、ISP、音视频编解码及模拟 IP 技术已在智能汽车及相关智能硬件终端实现规模化量产。此次整合将大幅提升公司在单车上的芯片覆盖度，并与亿智共同构成更庞大的汽车客户群体。 在非车业务方面，新的增量主要来源于消费级端侧市场，包括智能家电、运动相机、智能云台、AI 眼镜等。同时，公司将进一步拓展至扫地机、割草机等机器人和智能 AI 终端场景。公司的目标并非简单地将两家业务相加，而是通过统一产品规划、共享客户资源、复用算法与供应链，以及在晶圆、IP、封测等环节进行全体系协同，从而提升产品的复用率和市场导入速度。

行业内对于智驾方案存在软硬一体和解耦两种路线，如何看待这两种路径的竞争优劣势？公司的战略选择是什么，以及与元戎启行的合作有何最新进展？

垂直整合与生态合作这两种模式在各行业普遍存在。以智能手机行业为例，既有苹果、华为这类成功的垂直整合案例，也有许多投入巨大但最终失败的案例。在

智能驾驶领域，特斯拉是垂直整合的典型成功范例，但截至目前，其他尝试者尚未有明确的成功案例，部分早期尝试者已显现出走向失败的趋势。 从半导体行业的角度看，生态合作是更重要的方向，其价值远大于垂直整合，因为它能让各方发挥自身最强的优势。因此，公司坚持生态合作的路线，与生态链上的各个环节共同打造完整的解决方案。 与元戎启行的合作进展顺利。元戎启行最新的算法已成功部署在 A2000 芯片上，相关车辆已经跑通。其算法直接使用 FP16 格式运行，这证明了 A2000 芯片算力性能优越且易于部署，有效解决了 AI 模型从服务器端训练到芯片端部署时因量化而导致性能大幅下降及需要长时间微调的行业痛点。公司计划在不久后邀请相关人士试乘与元戎启行合作的车辆，目前仍在对最终效果进行微调。 总体而言，两种路径没有绝对的优劣之分。但随着算法和整体解决方案功能的成熟与完善，行业分工和生态整合将成为主流，这与 Mobileye 早期作为完整解决方案提供商推动产业发展，但后期因垂直整合模式而遭遇发展瓶颈的历程相符。公司将与更多合作伙伴共同推动乘用车、商用车乃至 L3/L4 级别无人配送等领域的解决方案发展。

除了汽车领域，公司算力芯片未来的应用场景将如何拓展？未来三年，哪些新方向可能成为最大的增量看点或率先实现放量？

公司最初从车规级芯片切入，整合亿智电子后，产品线已从高可靠、高耐久、高安全性的车规级芯片，拓展至满足高性价比需求的消费级解决方案。 汽车市场依然是公司持续投入的重点。尽管资本市场对智能驾驶存在疑虑，但该领域仍有巨大增长潜力。一方面，智能驾驶正在升级，行业关注点从实现城市 NOA、高速 NOA 等功能，转向关注本质安全，这对芯片、算法等各方面提出了更高的要求。另一方面，在 200 TOPS 以上算力的中国市场，海外芯片仍占绝大多数份额，这为国产芯片提供了良好的发展机遇。公司的 A2000 系列产品算力覆盖 200T、400T、700T、1,000T，并可通过一致性连接扩展至 2000 TOPS，能够支持当前大模型（包括世界模型和 VLA 模型）的部署。 具身智能是另一个非常看好的市场。该领域目前正处于爬坡阶段，呈现出碎片化和地域化的特点，需要多样化的解决方案。当前具身智能普遍缺乏“大脑”，而这正是公司能够提供核心能力的领域。

对于公司未来的业务增长点，除了汽车领域，还有哪些布局和规划？

公司未来的重要增长点将拓展至机器人和更广泛的端侧推理应用。将车规级产品应用于机器人领域，可有效解决其散热问题，包括关节和芯片本身的散热。尽管当前机器人市场体量不大，但其未来增长潜力巨大。 在端侧推理方面，通过与亿智的合并，预计 2026 年芯片总出货量将超过 1,000 万颗，有望成为中国智能驾驶方向出货量第一的公司，这将极大优化供应链、成本及客户支持。 此外，公司正在设计支持世界模型和语言模型的下一代高性能芯片，该芯片全面面向大模型，预计于 2027 年年底左右推出解决方案。该方案除了服务于汽车和机器人市场，还将拓展至更多端侧推理应用，例如 Agent AI。通过多颗芯片的组合可以部署 300B 至 700B 级别的大模型，并集成各类 Agent。这一布局旨在解决前端侧推理面临的两大核心问题：一是数据安全，二是应用成本，避免因

人在草木间

量 token 而产生高昂费用却效果不佳的情况。

从 2026 年下半年展望，公司乘用车业务中 A1,000、C1,200 和 A2000 三款芯片的出货节奏和各自产品线的增速将呈现怎样的差异？

公司芯片业务正处于存量项目迭代与新产品集中切换的阶段。2026 年下半年，A1,000 平台将有新增项目出货，同时 C1,200 和 A2000 平台已到达量产和批量出货的拐点，相关出货量预计从 2026 年第四季度开始，到 2027 年将逐步释放。 具体来看各产品线： A1,000 平台主要以存量项目稳定出货为主，增量更多来自乘用车以外的多元化赛道。在乘用车领域，正积极对接国内主流自主品牌的新车型，预计第四季度可新增 1 到 2 个车型定点。产品拓展方向主要有两个：一是与头部 Tier1 合作开发基于国标 AEB 的域控制器，有望实现全车型搭载；二是联合生态伙伴推出卫星式雷达域控方案，已获得多家 OEM 的意向需求。此外，该产品也在推动商用车高速 NOA 集成方案的量产落地。 C1,200 平台业务预计从 2026 年第四季度启动，进入高增长周期。下半年主要依托东风的标杆项目，在第四季度开始小批量爬坡，大规模出货预计在 2027 年多个定点车型 SOP 后得到充分释放。该产品定位为高性价比舱驾融合量产方案，并可作为具身智能设备的“小脑”，是一个集计算、控制、通信连接于一体的跨域计算平台。 A2000 平台在商用车领域已获得多家客户定点，并于本月（2026 年 9 月）开始首批规模订单交付。在乘用车领域，目前以 PCC 样片输出为主，随着定点车型陆续进入 SOP 阶段，预计 2027 年将迎来业务增速拐点。该芯片定位为高阶智驾的主算力平台，同时也可作为机器人的“大脑”，支持终端 AI 推理服务器等新兴业务场景。 未来三年，预计高阶智驾产品的出货量将超过百万套。包含亿智在内，公司累计车载芯片出货量预期将达到千万套以上。

在舱驾一体芯片业务方面，除了东风汽车，2026 年下半年及 2027 年还有哪些潜在客户值得期待？后续在该产品线上是否有更高算力的芯片布局？

舱驾融合方案的量产落地过程较长，但随着车厂思路转变、组织架构调整以及行业对成本的考量，该方案已逐渐被市场接受。东风项目取得了非常优秀的效果，预期量产规模可观。除东风外，其他国营车厂乃至国外车厂也对该方案表现出浓厚兴趣，目前正在进行技术对接。 公司坚定认为舱驾融合乃至未来的中央计算，在成本、性能和功能上具有显著优势。在当前汽车行业竞争激烈的背景下，成本控制是关键考量因素。因此，下一代芯片的设计已经启动，将继续聚焦高性价比路线。新一代产品将致力于结合车辆传统的座舱功能与 AI 功能，提升 AI 的本地化响应性能，并同步增强传统座舱的性能表现，目标是让舱驾融合方案能够应用于更多中低阶车型。下一代舱驾或多域融合芯片的推出速度会比较快。

2026 年上半年商用车业务的整体落地情况如何？在 L3、L4 级别的高阶商用车领域，未来是否有具体的产品和项目落地规划？

2026 年上半年，商用车业务取得了显著进展。首先，与国内领先的客车企业达成合作，实现了对其全系列轻客和轻卡产品的覆盖，在每个细分市场的车型中，至少有 3 至 4 款车型搭载了公司的全平台智驾方案。其次，通过“保底+ADAS 合作”模式，A1,000 域控方案在国内前十的新能源轻卡主机厂中已覆盖 5 家，另有 3 家正在洽谈，预计到 2027 年，在新能源车厂的覆盖率可达到 80%以上。在出货量方面，随着多个定点项目在 2026 年进入爬坡阶段，A1,000 域控的出货量同比实现了大幅增长。 对于 L3、L4 高阶自动驾驶领域，目前的策略是优先布局封闭及半封闭作业场景，如公交、矿区、港口以及特定区域的无人物流。对于干线物流的 L4 级别自动驾驶，当前主要进行 POC 验证和技术预研，因为判断该领域的规模化商业应用仍需一定时间。

请介绍一下公司 2026 年上半年机器人类业务的出货情况、新增客户订单，以及公司在具身智能领域未来两到三年的发展思路与商业模式规划？

公司机器人相关业务目前整体处于 POC 验证、客户联合预研以及早期场景落地阶段，主要集中在技术验证、原型开发和标杆客户产品打磨。行业规模化量产的节点预计在 2026 年第四季度至 2027 年第一季度之间。客户层面，已与人形机器人、工业巡检、港口、船用等特定场景的多家头部机器人企业达成战略合作，并启动了全方位的产品联合开发，为规模化量产做好储备。2026 年上半年，与具身智能相关的销售额为 4,700 万元，涵盖移动底盘、机械臂、协作臂、人形机器人以及四足、六足机器人等产品的出货。 面向未来两到三年的具身智能行业快速迭代期，公司采取差异化的竞争策略，避免与纯渠道或纯垂直闭环厂商的同质化竞争。具体而言，通过发挥芯片平台的工程能力以匹配客户需求，实施“小客户场景破局”与“大客户深度绑定”的双轨战略，构建竞争壁垒。 在商业模式上，公司进行了体系化升级，不再局限于销售裸芯片。交付形态将包括硬件模组、底层软件工具链等一体化的系统及方案，以解决不同类型客户的底层开发痛点。商业节奏上，在 POC 和 Alpha 阶段，通过样机或联合开发体现价值；在量产阶段，除了批量供应芯片与模组外，还将为成熟的优质客户提供 IP 授权或共同研发特定垂直场景的产品及方案，形成多元化合作模式，以持续提升单客户价值和整体毛利率。

请详细拆分一下黑芝麻智能 2026 年上半年的经营情况？

珠海亿智（武当）在上半年实现了规模化量产，历史累计出货量达亿级，是一家商业化闭环成熟的端侧 AI SoC 公司，主要产品应用于智能车载和智能硬件领域。其上半年收入约为 1.6 亿元，并首次实现盈利转正，盈利水平达到千万级别以上。毛利率约为 50%，大部分业务采用款到发货模式。业绩增长主要得益于产品结构优化、高毛利产品占比提升以及新客户的批量导入。 未来两年的增长驱动力主要来自三个方面： 第一，存量业务的持续放量。基于现有的成熟芯片产品，继

续深化在智能车载、智能硬件等传统优势领域的客户渗透。 第二，增量赛道的拓展。一方面，利用黑芝麻智能在主机厂、机器人和边缘 AI 行业的客户资源与渠道，实现客户资源复用；另一方面，快速切入智能家电、AI 穿戴设备、扫地机器人、割草机等新兴泛端侧场景，扩大产品应用边界和出货规模。 第三，技术与产业协同驱动产品升级。亿智计划在 2026 年和 2027 年陆续推出新的流片产品，以打造更高算力、更深技术壁垒的端侧 AI 芯片，并持续打磨算法，完善工具链、算法和芯片的完整交付体系。

珠海亿智（武当）后续的产品布局，特别是下一代芯片的主要发力领域和发展规划是怎样的？

珠海亿智（武当）的核心优势在于其 AI 能力和多样化的 AI 芯片组合。下一代芯片将延续这一方向，重点是推出能填补黑芝麻智能与亿智现有产品线之间算力空白的新产品，预计在 2027 年上半年推出，覆盖包括具身智能在内的多种 AI 应用领域。这既是为了覆盖黑芝麻智能过去未涉及的市场，也是为了提升亿智自身芯片的性能。 在发展规划上，亿智与黑芝麻智能的结合将增强双方在车载领域的能力，特别是在软件工具链和芯片层面。通过此次整合，将补齐黑芝麻智能过去在低端智能驾驶领域产品线的短板，形成一个完整覆盖从低到高全系列需求的产品组合。

对于下一代芯片，公司预计在 2027 至 2028 年能够看到哪些具体的应用场景落地？

下一代芯片的研发重点是高性能的端侧推理计算，而非训练。主要聚焦于以下几个应用场景： 第一，智能驾驶领域。舱驾融合芯片是迈向中央计算的关键一步，对于智能汽车的全面推广至关重要，将是公司一个重要的产品系列。同时，随着全球及中国 L3、L4 乃至完全无人驾驶规范的陆续出台，市场对高阶智驾芯片的算力需求激增，特别是需要能够支持世界模型、语言模型等大模型的芯片，使车辆具备从“小脑”式的执行能力升级到“大脑”式的理解、推理和思考能力。 第二，AI Agent 的本地化部署。这是一个巨大的潜在市场，公司的产品设计将兼顾此类应用。目标是提供一个既安全又高效的硬件平台，能够全功能部署各类大模型和 Agent harness，支持“数字员工”7x24 小时高效工作。 第三，具身智能领域。除了赋予机器人“大脑”和“小脑”的能力外，另一个重要场景是机器人的训练。利用高性能推理芯片，可以在工厂等实际应用场景中构建虚拟世界，实现高效的机器人训练，改变当前依赖人工训练的低效模式。 总而言之，公司的产品方向是高性能、高可靠、高耐久性的推理计算芯片，以满足上述关键应用场景的需求。

公司提到的高性能端侧推理芯片，目前的研发进展和未来的时间节点规划是怎样的？

新一代高性能端侧推理芯片目前已进入设计阶段。产品推出的时间点仍在斟酌中，预计在 2027 年年底左右。 在供应链方面，公司进行了多方面的考量以应对当前的地缘政治敏感性。一方面，正在积极采用全球最先进的工艺，以满足高性能计算芯片的需求；另一方面，也在布局成熟的供应链，例如 7 纳米工艺，该工艺被认为能够满足大量应用需求，并且有更多的晶圆厂能够提供支持。公司在供应链部署方面已开展了大量工作，并处于行业前列。